

Conduction Cooled Assemblies

CONNECT AND PROTECT

nVent SCHROFF Conduction Cooled Assemblies (CCAs) bestehen aus einem konduktionsgekühlten Leiterplattenrahmen und umfassen Calmark Card-Loks, Aushebegriffe und konduktionsgekühlte Kodierung. Sie wurden für Leiterkarten entwickelt, die eine Kühlung in rauen Umgebungen benötigen, in denen eine Konduktionskühlung nicht eingesetzt werden kann. Die Baugruppe bietet auch die erforderliche strukturelle Stabilität des Plug-in-Moduls in Umgebungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.

VORTEILE VON NVENT SCHROFF CONDUCTION COOLED ASSEMBLIES:

- Zum Download verfügbare, standardkonforme CAD-Vorlagen für unkomplizierte Modifikationen
 - Inklusive Peripheriekomponenten wie Card-Loks und Aushebegriffe
 - 3-HE- und 6-HE-Vorlagen für VITA 46, VITA 48.2, VME und CPCI erhältlich
- Ersparnis von Zeit und Beschaffungskosten durch Verwaltung der gesamten Baugruppe über eine Artikelnummer
 - ESD-geschützte Verpackung verfügbar
 - Die Kits können auch Wärmeleitpads, EMV-Dichtungen und Beschriftungen gemäß Kundenanforderung beinhalten
- Leistungsstarke Optionen dank Card-Loks mit hoher Klemmkraft und toleranzausgleichenden Aushebegriffen
- Lösung konstruktionstechnischer und thermischer Probleme in Zusammenarbeit mit dem hausinternen
- Entwicklerteam Gefertigt in einer AS9100-konformen Fertigungsstätte

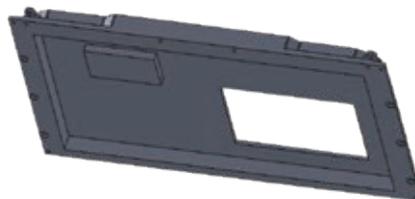


DREISTUFIGER KONSTRUKTIONSVORGANG

- 1 Nutzen Sie die umfassenden Konstruktionsleistungen von nVent SCHROFF oder laden Sie sich standardmäßige, vorkonfektionierte CAD-Vorlagen herunter.



- 2 Nehmen Sie Modifikationen je nach Leiterplatten-Layout und Kühlanforderungen vor.



- 3 Bestellen und verwalten Sie die CCA-Baugruppe als einzelne Artikelnummer. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:

- Heatframe und Clamshell
- Card-Loks
- Aushebegriffe
- ESD-Verpackung
- Wärmeleitpads
- EMV-Dichtungen

OPTIONEN ZUR LEISTUNGSOPTIMIERUNG:



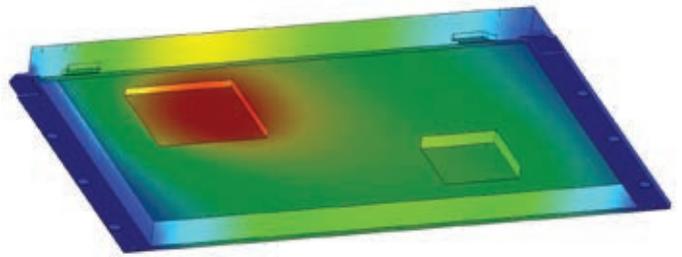
Die Klemmkraft lässt sich mithilfe von Card-Loks mit kleinem Profil und hoher Klemmkraft verdreifachen.



Bei der Card-Loks-Auslösung mit toleranzausgleichenden Aushebegriffen wird positiver Druck auf Steckverbindungen ausgeübt. Ideal für die Two-Level-Maintenance, manuelle Bedienung mit Handschuhen möglich.

UNSERE ENTWICKLUNGSKOMPETENZ:

- Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen, um eine thermische Analyse mithilfe von Software wie 6Sigma durchzuführen und Kühlprobleme zu lösen.
- In Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Entwicklerteam wird gewährleistet, dass Ihre Konstruktion den erforderlichen Standards gerecht wird.
- Beschleunigen Sie Ihren Konstruktionsprozess mit 3D-gedruckten CCAs und Rahmen für Passformprüfungen.



KEY CONDUCTION COOLED ASSEMBLY FEATURES:

- Gefertigt in einer AS9100-konformen Fertigungsstätte
- Konduktionsrahmen in 3 HE oder 6 HE erhältlich
- Für herausragende Korrosionsbeständigkeit schwarz eloxiert, chemisch beschichtet oder chemisch vernickelt erhältlich
- Aluminium 6061-T651 für hohe thermische Leitfähigkeit und geringes Gewicht
- Gewindestreifen zur Sicherung von Kartenfixierungen in Umgebungen mit extremer Vibrationsbelastung
- Card-Loks mit bis zu dreimal so hoher Klemmkraft wie herkömmliche Card-Loks vergleichbarer Größe; gleichmäßige Druckverteilung für minimalen Wärmewiderstand
- Maschinelle Fertigung des Rahmens und der Montageplatte aus jeweils einem einzelnen Stück für hohen Wärmeübergang und hohe strukturelle Festigkeit
- Siebdruck erhältlich
- ESD-Verpackung ermöglicht einfaches Entnehmen des Bausatzes und direkte Montage in der Umgebung ohne elektrostatische Aufladung
- Alle Montagekomponenten direkt im Bausatz lieferbar, mit Verpackung und Beschriftung nach Kundenanforderung

nVent SCHROFF GmbH

Langenalber Strasse 96-100
D-75334 Straubenhardt Germany
+49 (0) 7082 794 0



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER